

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 7 月 2 日(02.07.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/097917 A1

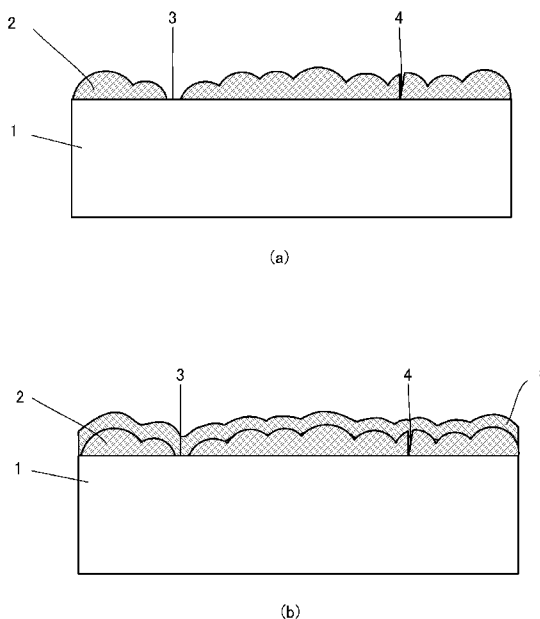
- (51) 国際特許分類:
C25D 5/10 (2006.01) C25D 7/00 (2006.01)
C25D 3/48 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/085281
- (22) 国際出願日: 2013 年 12 月 28 日(28.12.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 日栄技研株式会社(NICHIEI GIKEN KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒6078229 京都府京都市山科区勤修寺泉玉町 8 9 番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 林 茂(HAYASHI, Shigeru); 〒4910132 愛知県一宮市大毛字光田 1 5 番地 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 中井 宏行(NAKAI, Hiroyuki); 〒6510085 兵庫県神戸市中央区八幡通 4 丁目 2 番 1 2 号 フラワーロード第 3 ビル 9 階 協明国際特許事務所 Hyogo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: DOUBLE GOLD PLATING METHOD AND ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 2重金めっき方法及び電子部品

[図1]



(57) Abstract: Provided are: a low-cost gold plating method having excellent anticorrosion properties; and an electronic component which is produced using this gold plating method. In this double gold plating method, a base gold plating layer (2) is formed on the surface of a material to be plated (1) in a first plating process, and then a finishing gold plating layer (5) is formed on the surface of the base gold plating layer (2) by having gold crystals finer than those during the formation of the base gold plating layer (2) precipitate on the surface of the base gold plating layer (2) in a second plating process.

(57) 要約: 低コストで防食性に優れた金めっき法と、その金めっき法を用いて製造された電子部品が提供される。2重金めっき方法では、第1のめっき処理として、被めっき材1の表面に基礎金めっき層2を形成し、その後、第2のめっき処理として、前記基礎金めっき層2の表面に、前記基礎金めっき層2の形成時よりも微小な金の結晶を電解法で析出させて、仕上げ金めっき層5を形成する。

WO 2015/097917 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

— 補正された請求の範囲 (条約第 19 条(1))